

化学工学会 第 50 回秋季大会
部会横断型シンポジウム<CVD・ドライプロセス-デバイス構造・機能制御の反応工学->
報告書

オーガナイザー

秋山 泰伸(東海大学)

筑根 敦弘(大陽日酸(株))

野田 優(早稲田大学)

2018 年 9 月 18～20 日に鹿児島大学で開催された化学工学会第 50 回秋季大会にて本シンポジウムが開催され、合計 19 件の講演発表が行われた。詳細は下記の通りである。

日時	9 月 19 日 13:00～15:00 5 件(展望講演 1 件を含む) 9 月 20 日 9:00～15:00 14 件(展望講演 1 件、招待講演 2 件を含む)
会場	鹿児島大学郡元キャンパス
聴講者数	37 名
展望講演	『熱 CVD 法を用いた切削工具用硬質膜の開発と展望』谷渕栄仁氏(京セラ) 『接触分解反応による活性種を利用した薄膜堆積と表面改質:HWCVD 法の基礎と応用展開』和泉亮氏(九工大工)
招待講演	『グラフェンをはじめとする二次元材料の CVD 成長と生成機構』吾郷浩樹氏(九大 GIC/産総研) 『プラズマエッチングにおける SiO ₂ /Si 界面準位の生成と制御』○長畑和典氏・重歳卓志氏(ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング)

その他:なお、オーガナイザー内に材料・界面部会員がいないため、部会事務局の山本大吾(同志社大学)が本報告書を作成した。

以上